

【19】中華民國

【12】發明公開公報 (A)

【11】公開編號：201931477

申請實體審查：有

【43】公開日：中華民國 108 (2019) 年 08 月 01 日

說明書修正日期：

中華民國 108 年 02 月 21 日

【51】Int. Cl. :

H01L21/56 (2006.01)

H01L21/67 (2006.01)

【54】發明名稱：用於封裝半導體晶片之設備及方法

APPARATUS AND METHODS FOR PACKAGING SEMICONDUCTOR  
DIES

【21】申請案號：107137898

【22】申請日：中華民國 107 (2018) 年 10 月 26 日

【30】優先權：2017/11/03

美國 62/581,451

【72】發明人：傅博詣 (CN) FU, BOYI；陳 翰文 (US) CHEN, HAN-WEN；曹 圭日 (US)  
CHO, KYUIL；卡納帕西亞潘 西法帕奇亞 (US) GANAPATHIAPPAN,  
SIVAPACKIA；寇克 羅門 (US) GOUK, ROMAN；維哈佛貝可 史帝文  
(BE) VERHAVERBEKE, STEVEN；帕逖邦德拉 納格 B (US)  
PATIBANDLA, NAG B.；趙岩 (CN) ZHAO, YAN；黃 浩智 (SG) NG, HOU  
T.；弗拉 安基特 (IN) VORA, ANKIT；張 代化 (US) ZHANG, DAHUA

【71】申請人：美商應用材料股份有限公司 APPLIED MATERIALS, INC.  
美國

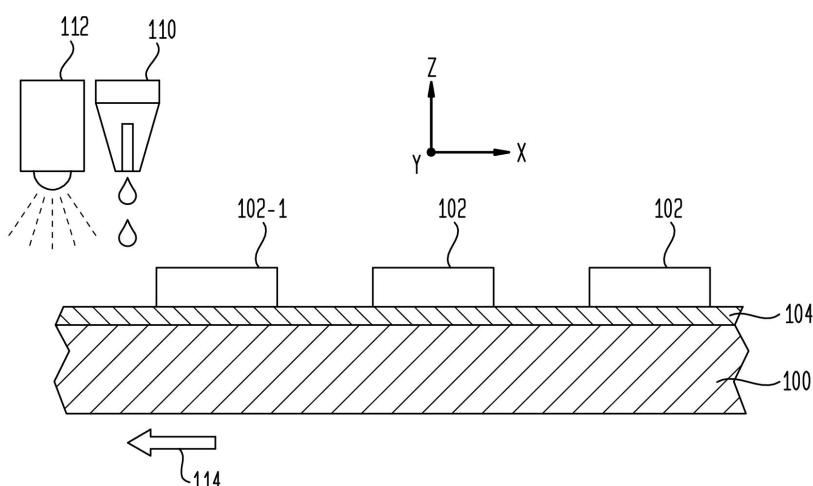
【74】代理人：李世章；彭國洋

【57】發明摘要：

本揭示內容的態樣一般涉及將晶片固定在基板上之方法。在一種方法中，在基板上形成一或多個固定特徵，所述一或多個固定特徵呈選擇的圖案。安置晶片，使晶片接觸所述一或多個固定特徵和基板。硬化所述一或多個固定特徵，並於經硬化之一或多個固定特徵和晶片的頂部上形成模層，以便包覆晶片。

指定代表圖：

第 1A 圖



符號簡單說明：

100 ··· 基板

102、

102-1 ··· 晶片

104 ··· 接觸層

110 ··· 印刷機

112 ··· 硬化裝置

114 ··· 箭頭